

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

转债代码：118049

转债简称：汇成转债

# 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会)

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动时间	2025年5月23日 15:30~16:30
活动地点	价值在线（业绩说明会网址： <a href="https://eseb.cn/1oipR0hQDOo">https://eseb.cn/1oipR0hQDOo</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：郑瑞俊 独立董事：蔺智挺 副总经理：林文浩 董事会秘书：奚勰 财务总监：闫柳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、截止2025年4月30日，产能利用率是多少？同比变化率多少？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2025年第一季度受节假日、产业周期波动等因素影响，公司整体产能利用率为七成左右，与上年同期基本持平。</p> <p>2、有没有赚钱？偶尔会赚多少？公司价值在哪裡？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2022-2024年，公司归属于母公司</p>

	<p>所有者的净利润分别为 17,722.50 万元、19,598.50 万元、15,976.42 万元，具备相对稳定的盈利能力。</p> <p><b>3、未来如何提升产能利用率以摊薄固定成本？是否有调整产品结构（如提升高毛利的 COF 产品占比）或优化定价策略的计划？</b></p> <p>黄金价格波动对传统金凸块制程的成本影响显著，公司转向铜镍金、钯金等新型制程的进度如何？预计何时能实现规模化生产以降低对金价的依赖？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司将充分把握产能转移及国产替代自主可控的产业趋势，持续拓展增量客户，提升市场份额，从而提高产能利用率，尽量降低新增设备折旧摊提的影响。同时，公司正持续推进产品结构改善，提高毛利水平相对较高的 AMOLED、大尺寸显示驱动芯片封测业务比重，从而提升盈利水平。在代工价格方面，本年度内目前相对维持稳定，公司将通过推进铜镍金、钯金等新型凸块制程产能落地，以满足客户降低封测端代工成本的需求。</p> <p>黄金价格波动主要由下游客户承担，对公司盈利水平的影响相对较小。铜镍金和钯金凸块制程项目目前正在推进当中，预计将于本年度内完成产能建设并贡献营业收入。</p> <p><b>4、当前公司可转债项目及扩产投入是否加剧债务压力？如何平衡资本开支与偿债能力？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！截至 2025 年一季度末，公司合并范围资产负债率为 30.34%，可转债融资系公司整体负债率上升的主要影响因素。公司当前现金储备相对充裕，经营活动现金流良好，具备较好的偿债能力。</p> <p><b>5、可转债募投项目新增产能是否与下游需求增长匹配？是否有明确的大客户订单支撑扩产计划？</b></p> <p>车规芯片项目（汇成二期）当前厂房建设进度如何？车规认证周期较长，公司如何应对量产前的空窗期风险？</p>
--	---

**答:**尊敬的投资者您好!公司可转债募集资金主要用于12吋先进制程新型显示驱动芯片封装测试全制程扩能,以满足持续增长的OLED显示驱动芯片封测需求。自可转债募投项目逐步投产以来,OLED显示驱动芯片封测业务营收占比整体呈上升趋势,新增产能与下游需求的变化趋势整体匹配。

车规芯片项目厂房已于近期完成封顶,公司正积极推进厂房建设及无尘室改造工程。公司及全资子公司江苏汇成已于2024年9月份通过汽车行业质量管理体系IATF 16949:2016正式认证,并取得注册证书。车规级显示驱动芯片主要客户与公司现有客户存在重叠,具备较好的客户基础,公司正积极推进车规级显示驱动芯片客户验证及产品导入。

**6、前五大客户收入占比虽从73.48%降至66.37%，但仍高于行业平均水平。在AMOLED、车载等新领域，公司是否已绑定京东方、特斯拉等核心客户？如何应对联咏、天钰等台厂客户需求波动？**

**韩系客户（如三星、LG）导入进度如何？是否计划通过技术合作或并购拓展海外市场？**

**答:**尊敬的投资者您好！公司所处显示驱动芯片细分领域芯片设计环节集中度相对较高,因此对主要客户的收入占比相对较高。基于在显示驱动芯片细分领域的持续深耕,公司已与业内主要芯片设计公司及下游面板厂商、终端品牌建立了良好的合作关系,相关客户需求及订单具备相对较好的稳定性。

公司已通过部分韩系客户技术验证,尚处于产品导入阶段。海外市场是公司重要的发展方向,公司将持续拓展相关领域的重点客户。

**7、公司预计何时能实现AMOLED封测的规模化放量？车载芯片验证进展及量产时间表？**

**答:**尊敬的投资者您好！AMOLED显示驱动芯片在中国大陆地区的封测需求受到AMOLED面板渗透率、相关芯片设计

	<p>公司市场份额、相关晶圆代工厂产能支持等多方面影响。公司基于可转债募投项目持续拓展 OLED 等新型显示驱动芯片封测产能，并将持续伴随产业链合作伙伴共同推进 AMOLED 显示驱动芯片渗透率及市场份额提升。</p> <p>公司及全资子公司江苏汇成已于 2024 年 9 月份通过汽车行业质量管理体系 IATF 16949:2016 正式认证，并取得注册证书。车规级显示驱动芯片主要客户与公司现有客户存在重叠，具备较好的客户基础，公司正积极推进车规级显示驱动芯片客户验证及产品导入。</p> <p><b>8、行业人才竞争激烈，公司如何防止技术骨干流失？是否有股权激励或长期培养计划？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司通过包括股权激励和员工持股计划在内的诸多激励措施，与核心团队建立了较好的利益共享风险共担约束机制。同时，公司已形成了相对完善的人才培养及梯队建设机制，核心技术团队稳定性相对较好。</p> <p><b>9、与投资者关系的维护和互动方面，还请董事长百忙中关注这个方面，最好每月都能答复投资者的关切。</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司将完善投资者沟通及意见反馈机制，保持投资者热线电话等沟通渠道畅通。投资者关切的问题可以通过电话、邮箱、上证 e 互动和投资者说明会等多种方式提出，公司将在遵守信息披露相关法律法规的前提下积极回应投资者关切的问题。</p>
是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	无
上传日期	2025 年 5 月 23 日